

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年8月8日(08.08.2024)



(10) 国際公開番号

WO 2024/162075 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/302 (2006.01) H01L 21/3065 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/001693

(22) 国際出願日: 2024年1月22日(22.01.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-012160 2023年1月30日(30.01.2023) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 戸田 聡(TODA, Satoshi); 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社内 Yamanashi (JP). 中込 健(NAKAGOMI, Ken); 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢

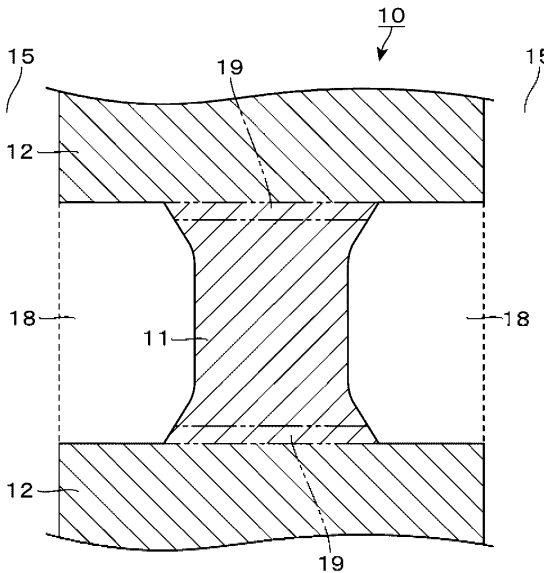
650東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社内 Yamanashi (JP). 今村 健太郎(IMAMURA, Kentaro); 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社内 Yamanashi (JP). 入江 伸次(IRIE, Shinji); 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢650東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社内 Yamanashi (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人弥生特許事務所(YAYOI PATENT OFFICE); 〒2310058 神奈川県横浜市中区弥生町2丁目15番1号ストークタワー大通り公園3601号 Kanagawa (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

(54) Title: ETCHING METHOD AND ETCHING DEVICE

(54) 発明の名称: エッチング方法及びエッチング装置



(57) Abstract: This etching method comprises an etching step for supplying a halogen-containing gas and an amine gas to a substrate having a silicon layer formed on the surface thereof to etch said silicon layer.

(57) 要約: エッチング方法は、表面にシリコン層が形成された基板に、ハロゲン含有ガスとアミンガスとを供給して、前記シリコン層をエッチングするエッチング工程を含む。

[続葉有]

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))